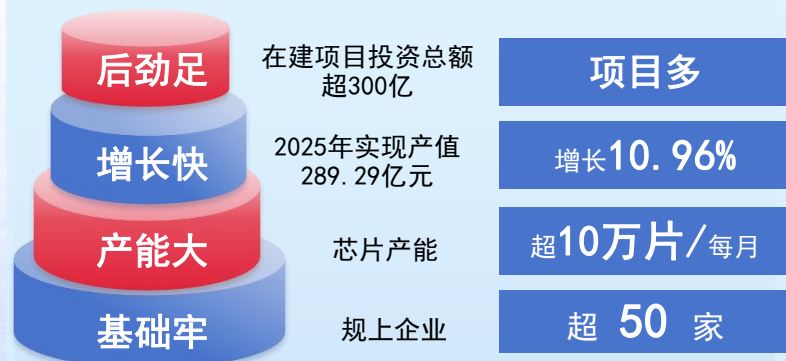


打造国家集成电路产业发展“第三极”核心承载区

产业基础雄厚

规模效应明显



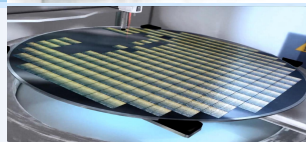
产业链条完备

上游：设计、材料与装备
设计：慧智微、安凯微、泰斗微
材料装备：广钢气体、中微



中游：芯片制造

重点企业：粤芯半导体、增芯科技、芯粤能



下游：封测和应用

封装：兴森快捷、广芯封装、芯聚能
测试：电子五所、广电计量
应用方面：广汽、小鹏车载芯片年需求超20亿颗



核心优势显著

差异化发展

聚焦**成熟工艺**、**智能传感器**、**第三代半导体**等多条技术路线



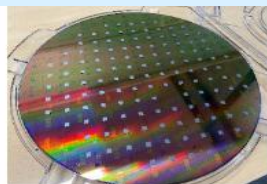
创新平台实力强

工业和信息化部电子第五研究所（赛宝）
具备车规AEC-Q认证资质并入选国家级中试平台



广州光电存算芯片融合创新中心

许宁生院士牵头、广州高新区与中山大学、复旦大学共建，
光电子与光子集成中试平台

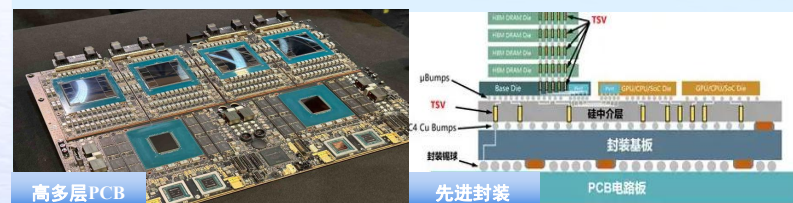


300毫米（12英寸）硅基铜互层集成晶圆

发展土壤肥沃

未来发展思路

以**粤芯**、**增芯**、**芯粤能**为牵引，做强特色芯片制造与第三代半导体。同步推进**高端电子电路**、**光电子**和**先进封装**集成。



“一核两极”空间布局

